

2023年12月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年5月15日

上場会社名 ウインタスト株式会社
コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 姜 輝
問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 樋口 真康
四半期報告書提出予定日 2023年5月15日
配当支払開始予定日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
TEL 045-317-7888

(百万円未満切捨て)

1. 2023年12月期第1四半期の連結業績(2023年1月1日~2023年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年12月期第1四半期	82	59.8	131		138		139	
2022年12月期第1四半期	51	51.2	177		165		165	

(注) 包括利益 2023年12月期第1四半期 114百万円 (%) 2022年12月期第1四半期 125百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年12月期第1四半期	3.75	
2022年12月期第1四半期	4.96	

(注) 2023年12月期第1四半期及び2022年12月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	%	%
2023年12月期第1四半期	1,881		1,479		78.0	
2022年12月期	1,902		1,352		70.6	

(参考) 自己資本 2023年12月期第1四半期 1,468百万円 2022年12月期 1,343百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年12月期		0.00		0.00	0.00
2023年12月期					
2023年12月期(予想)		0.00		0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年12月期の連結業績予想(2023年1月1日~2023年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計) 通期	1,300	518.1	50		50		50		1.35

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、通期での業務管理を行っておりますので、第2四半期(累計)の連結業績予測の記載を省略しております。

注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 有 |
| 以外の会計方針の変更 | : 無 |
| 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| 修正再表示 | : 無 |

(注)詳細は、添付資料P.9「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年12月期1Q	38,129,500 株	2022年12月期	36,072,000 株
期末自己株式数	2023年12月期1Q	株	2022年12月期	株
期中平均株式数(四半期累計)	2023年12月期1Q	37,077,650 株	2022年12月期1Q	33,381,242 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また、上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(1) 経営成績に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(会計方針の変更)	9
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	11
3. その他	12
継続企業の前提に関する重要事象等	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間（2023年1月1日～2023年3月31日）における世界経済は、金融関連の混乱や高インフレ、ロシアによるウクライナ侵攻長期化などの影響、また3年にわたる新型コロナウイルス感染症を受けて、見通しは再び不透明さを増しており、経済成長率は、2022年の3.4%から2023年は2.8%へ鈍化しており、アナリストによる世界経済の成長率予測が2023年下期には、約2.5%にまで低下するとの予測もある中、先進国の成長率は1%を下回るようになるとの見解もあり、予断を許さない状況が続いております（世界経済見通し WEO）。同期間における我が国経済に目を向けると、日銀短観では、周辺国との地政学的な影響も色濃く受け、また円安による原材料高が我が国経済を直撃し、製造業を中心に景況感が低迷、加えて世界的な半導体需要の落ち込みから電子機器の需要も悪化しております。一方、個人消費やインバウンド需要の回復を背景に、小売などの消費関連の景況感は改善しており、第3次産業活動指数は、現時点の2023年3月では、前月対比+0.9%と2か月ぶりの上昇。新型コロナウイルスの感染状況の落ち着きを受けて、運輸業・郵便業や生活娯楽関連サービスなどが上昇しております。

当社グループが属する半導体並びにフラットパネルディスプレイ業界におきましては、世界的なテレワーク需要の減少を背景に、民生品向け半導体やフラットパネルディスプレイの需要が急減、在庫がダブつく事態となり、最終製品の出荷数量も、PCモニターやノートPC、スマートフォンなどを中心に全体の数量として大きく減少しております。その結果、年初からパネル等の価格も下落が続き、中国のディスプレイパネルメーカーを中心に工場の稼働率を下げる動きが目立ち、それに伴い新規設備投資にも慎重さが目立ちます。しかしその反面徐々に、5Gなどのインフラの整備が進み、車載、AR/VR、パブリックディスプレイなどの新規アプリが伸びており、特にパブリックディスプレイは欧米やアジアの一部がロックダウンを解除し、公共の場に大勢の人が出てくるようになったことから、そうした場所に新たにディスプレイを設置するニーズが高まりを見せており、2023年下期には各工場における、製造調整も一段落、スマホやPC等を中心に既存分野も回復することが期待され、生産数量、出荷数量ともに増加に転じるものと期待されております（Omdia社）。また今後の半導体市場は今後の10年は、データセンターやGX投資（グリーン投資）など、官民両輪によるインフラの整備がけん引役となり、足元のリセッションにも負けず、力強く成長すると見られております（EETIMES）。

このような環境下、当社グループの主要事業である半導体検査装置事業では、中国、台湾のLCDドライバーIC等のデザインハウスやOSATの設備投資意欲が減退するなか、2023年下期といわれる生産調整の終了を睨みつつ、引続き現地の顧客ニーズに適合したLCDドライバーIC検査装置や、次世代検査ユニットなどの開発を継続しています。

また、営業面では販売店に集中させていた、販売方法を見直し当社の製造子会社の営業を含めた直接販売も拡大することとし、現地マーケットに集中した営業展開を開始いたしました。しかしながら当第1四半期連結累計期間においては、上述のように、お客様工場の在庫のだぶつきから生産調整が発生、その影響を受け計画されていた設備投資もまた第2四半期連結会計期間以降となることとなりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の当社グループの売上高は82,583千円（前年同四半期比59.8%増）、営業損失131,890千円（前年同四半期は営業損失177,005千円）、経常損失138,499千円（前年同四半期は経常損失165,033千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失139,119千円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失165,652千円）となりました。

なお、セグメント区分については、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、当第1四半期連結累計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート（大阪府大阪市北区）に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度に比べ20,358千円減少し、1,856,942千円（前連結会計年度末比1.1%減）となりました。この主な要因は、現金及び預金が89,418千円減少したことによるものです。

固定資産は、前連結会計年度に比べ110千円増加し、25,053千円（前連結会計年度末比0.4%増）となりました。この主な要因は、投資その他の資産のその他が110千円増加したことによるものです。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度に比べ139,007千円減少し、234,727千円（前連結会計年度末比37.2%減）となりました。この主な要因は、短期借入金が157,030千円減少したことによるものです。

固定負債は、前連結会計年度に比べ8,452千円減少し、167,339千円（前連結会計年度末比4.8%減）となりました。この主な要因は、長期借入金が8,433千円減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度に比べ127,210千円増加し、1,479,928千円（前連結会計年度末比9.4%増）となりました。この主な要因は、資本金及び資本剰余金がそれぞれ119,699千円増加したことによるものです。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、液晶パネルに使われるDDIC（ディスプレイドライバIC）の検査に使用されており、また、それら情報端末ではLCDドライバICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど多種に渡る周辺半導体デバイスが使われております。現状足下では、景気の足踏み状態が続いておりますが、中長期的には需要も戻り、大きな伸びが期待される分野です。

当社の主力検査装置WTS-577SRにつきましては、2021年から販売を開始し、当第1四半期連結累計期間において、装置の貸出しを伴うベンチマークに積極的に取り組み、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができましたが、上記、「（1）経営成績に関する説明」にも記載したような理由から新規の受注にはまだ至っておりません。

JETRO等の予想では2023年の半導体は、メモリーでは、在庫調整が2023年後半まで続くとの見方がありますが、半導体製造装置セクターにおいては、2023年前半は落ち込むが後半は回復へ（JETRO分析レポート）との予測もあり、受注は当年度第2四半期連結会計期間以降を予定しております。

今後販売店戦略の見直しを行い、当社の中国製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」（以下、「ウインテスト武漢」という。）の営業体制の拡大強化を行い、受注残の早期納入、海外営業と海外アフターサポート体制の拡充を進め、営業活動を見直してまいります。

次に、ウインテスト武漢においては、コストの削減と顧客対応力の両方を強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

さらに中国市場攻略のスピードアップを進めるため、ウインテスト武漢において、大手優良デザインハウス数社に的を絞った戦略を取り、関連するOSATへの貸出しを進め、営業、納入、サポートと一貫体制を敷き、顧客からの信頼獲得を図ってまいります。

検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については、既にお知らせのとおり手続きは終了しております。当該技術は当社の検査装置とウェーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーター一人で簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレータ」という。）で製品化を目指し、当面の目標として、その搬送可能重量を50kg前後で製品化を行います。その後応用製品として「半導体製造工場内FA化システム」、「物流搬送システム」や「介護等」への応用が可能と考えております。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG、ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し、製品化行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたように、2023年4月1日より試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造につきましては当社大阪事業所で製造を行います。詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

なお、2023年2月15日の「2022年12月期 決算短信」で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	278,480	189,061
売掛金	21,058	76,508
電子記録債権	21,670	21,670
商品及び製品	215,344	252,224
仕掛品	797,167	784,607
原材料及び貯蔵品	506,251	509,106
前渡金	8,677	1,265
未消費税等	13,270	13,867
その他	15,381	8,630
流動資産合計	1,877,301	1,856,942
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物(純額)	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具(純額)	—	—
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品(純額)	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	27,827	27,937
貸倒引当金	△2,884	△2,884
投資その他の資産合計	24,943	25,053
固定資産合計	24,943	25,053
資産合計	1,902,244	1,881,995

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	21,750	8,229
短期借入金	157,030	—
1年内返済予定の長期借入金	32,064	32,064
未払金	75,020	55,315
未払法人税等	10,689	4,487
賞与引当金	—	5,919
契約負債	45,696	105,845
製品保証引当金	300	552
その他	31,183	22,314
流動負債合計	373,734	234,727
固定負債		
長期借入金	169,030	160,597
リース債務	343	300
資産除去債務	6,418	6,442
固定負債合計	175,791	167,339
負債合計	549,526	402,067
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,210,563	1,330,263
資本剰余金	1,497,050	1,616,749
利益剰余金	△1,468,555	△1,607,674
株主資本合計	1,239,059	1,339,339
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	104,158	129,033
その他の包括利益累計額合計	104,158	129,033
新株予約権	9,500	11,555
純資産合計	1,352,717	1,479,928
負債純資産合計	1,902,244	1,881,995

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
売上高	51,678	82,583
売上原価	42,438	41,504
売上総利益	9,239	41,078
販売費及び一般管理費	186,245	172,969
営業損失(△)	△177,005	△131,890
営業外収益		
受取利息	7	11
為替差益	12,601	—
その他	303	590
営業外収益合計	12,912	601
営業外費用		
支払利息	655	2,540
為替差損	—	3,457
その他	285	1,212
営業外費用合計	940	7,210
経常損失(△)	△165,033	△138,499
税金等調整前四半期純損失(△)	△165,033	△138,499
法人税、住民税及び事業税	619	619
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	619	619
四半期純損失(△)	△165,652	△139,119
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△165,652	△139,119

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)
四半期純損失 (△)	△165,652	△139,119
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	40,237	24,874
その他の包括利益合計	40,237	24,874
四半期包括利益	△125,415	△114,244
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△125,415	△114,244
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業に関する注記）

当社グループは前連結会計年度において、半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円と低調な結果となり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上しております。

当第1四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって中国で起きた「各種規制」の影響を主な要因として、これまで市場をけん引してきたスマートフォンや情報端末の販売が急激に鈍化したこと、並びに先進各国において勧められてきたテレワークの減少に伴い、PC及びネットワーク機器などのPC周辺機器に関しても大きく需要が減速、民生機器向け半導体を中心に在庫がだぶつき、各生産工場は生産調整に入りました。このことから当第1四半期連結累計期間における新規設備投資は見送られ、受注残の出荷並びに新規の受注は第2四半期連結会計期間以降となりました。

以上より、当社グループの連結ベース売上高は、82,583千円にとどまり、半導体検査装置事業の利益率が低調であったこと及び労務費・販管費等も増加したことから、営業損失131,890千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を139,119千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失を計上している状況にあり、当社グループには継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

事業施策

1. 中国国内での受注販売活動の促進

まず、上記で述べたように2022年下半年から顕在化したテレワークの減少や、中国各地でのロックダウン等、新型コロナウイルス感染症に伴う各種の規制の影響で最終製品の更新サイクルが鈍化し、半導体チップ、特にスマートフォンやPC、そしてIT機器などの需要が大きく後退、各半導体工場における在庫調整が発生しました。そのため最終製品市場の市況は大きく後退、在庫増が嫌気され、薄型パネルを含めた、PC等の民生機器向け半導体部材の在庫調整を急ぐデザインハウスの計画修正を受ける形でOSATは、工場の稼働率を5割程度まで削減、その結果、市場は新規設備投資に慎重な姿勢に変化しています。しかし、中期的に2023年7月以降の半導体市場は、各国政府の進めるDX（デジタルトランスフォーメーション）のさらなる進展や脱炭素化推進に向けた取り組み、自動運転や5G、6Gなどの高速通信環境がもたらす新しい世界（VRやメタバース）が急速に拡大、また半導体市場は、今後の10年、データセンターやGX投資（グリーン投資）など、官民連携によるインフラの整備がけん引役となり、足元のリセッションにも負けず、力強く成長すると見られております（EETIMES）。

また、近年の半導体の複雑化や集積度向上（例、線幅4nmから2nm）は半導体の機能の増加を意味し、検査時間の伸長に繋がります。しかしながら、同時に量産性も要求されるため、半導体テスト市場は、装置能力の向上に加え装置台数の増加が期待される方向と考えております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、液晶パネルに使われるDDICの検査に使用されており、また、それら情報端末ではLCDドライバICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど周辺半導体デバイスの需要も大きな伸びが期待される分野です。当社の主力検査装置WTS-577SRにつきましても、2021年から販売を開始し、2022年時点において、装置の貸出しを伴うベンチマークに積極的に取り組み、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができました。上述のような理由から新規の受注にはまだ至っておらず、JETRO等の予想では2023年の半導体は、メモリーでは、在庫調整が2023年後半まで続くとの見方がありますが、半導体製造装置セクターにおいては、2023年前半は落ち込むが後半は回復へ（JETRO分析レポート）との予測もあり、受注は当年度第2四半期連結会計期間以降を予定しております。

今後、販売戦略の見直し、及び当社の中国製造子会社「偉恩測試技術（武漢）有限公司」（以下、「ウインテスト武漢」という。）との体制強化を行い、また台湾にも営業所を計画するなど、中国及び台湾の営業強化と海外アフターサポート体制の強化を進め、営業活動を行ってまいります。さらに、ウインテスト武漢においては、コストの削減と顧客対応力の両方を強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。その上で中国市場攻略のスピードアップを進めるため、大手優良デザインハウス数社に絞った戦略を取り営業、納入、サポートと一貫体制を敷き、顧客からの信頼獲得を図ってまいります。

2. 技術開発の強化

先端ロジックIC検査装置（1024チャンネル、820Mbps）に関しては、2024年第1四半期でのリリースを目指しております。国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代LCDドライバ検査装置と共用することで、開発期間の短縮を狙い、市場へリリースできるように計画しております。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理

技術、高精度センサー技術、データ解析技術を応用、且つ大阪事業所、ウインテスト武漢の技術陣と協働し、今後の市場拡大が見込まれるメモリーやデジタルICチップ等の検査分野、5Gとその後の6G通信規格の台頭とともに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を2025年までに目指し、M&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携を積極的に進め、当該分野への新規参入、対応可能検査範囲の拡充と展開を計画、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

3. 隣接領域の展開と製品化

自重補償機構技術では、新型コロナウイルス感染症による停滞を経て、引き続き学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターとともに機械加工製造会社の選定中であり、製造に向けて進めております。当該装置は、当社の検査装置とウェーハ又はハンドラーとのドッキングに使用する「マニピュレータ」で製品化を目指し、検査装置のポゴタワーと呼ばれる着脱補助装置とします。なお、基本設計、特許関連の手続きは終えております。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し、製品化行いました。2023年3月9日に開示しました「IoTセンサーを活用したセルフヘルスケア機器の販売開始決定及び価格に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、2023年4月1日より試験販売を開始いたしました。なお、当該製品の製造に関しましては当社大阪事業所で製造を行います。詳細につきましては、当社WEBページをご参照ください。

財務施策

財務面については、財務基盤の安定化を図るために、2023年1月13日開催の取締役会において、GFA株式会社を割当先とする第三者割当による新株予約権の発行を決議し、2023年1月30日にその引受代金の払込完了、当第1四半期末連結会計期間末までにその行使により236百万円を調達済であり、今後残りの行使分も順調に行われると見込まれます。筆頭株主である武漢精測と諮りながら、同社及び金融機関からの借入、並びに資本増強等による資金確保についての施策を今後とも継続して実施してまいります。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でありますが、アフターコロナ、テレワーク需要の減少などの影響で半導体市場は、在庫の積み上がりを嫌い、生産調整から設備投資の大幅な減退をうけ半導体市場は大きく低迷しております。当社がメイン市場とする海外の新規受注並びに受注済み検査装置の出荷、売上は、中国経済が上向くと見込まれる当年度半ば以降となります。事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、前記の新株予約権による調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、当四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当四半期連結財務諸表に反映しておりません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第1四半期連結累計期間（自2023年1月1日至2023年3月31日）

当社は、当第1四半期連結累計期間に、第三者割当の方法による第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ119,699千円増加し、当第1四半期連結累計期間末において資本金が1,330,263千円、資本剰余金が1,616,749千円となっております。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用方針）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)

「II 当第1四半期連結累計期間 (報告セグメントの変更等に関する事項)」に記載のとおりです。

II 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、前連結会計年度に「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート (大阪府大阪市北区) に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

当社の報告セグメントは単一セグメントになることから、前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間におけるセグメントの情報の記載を省略しております。

(重要な後発事象)

新株予約権の行使による増資

当第1四半期連結会計期間の末日の翌日以降、2023年5月12日までに第11回新株予約権（行使価額修正条項付）の一部の権利行使が行われました。当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

(1) 行使新株予約権個数	7,500個
(2) 資本金の増加額	42,137千円
(3) 資本準備金の増加額	42,137千円
(4) 増加した株式の種類及び株数	普通株式 750,000株

3. その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは前連結会計年度において、半導体需要のダブつきによる工場稼働率の調整の影響を受け、売上・受注時期がずれ込み、売上高210,315千円と低調な結果となり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上しております。

当第1四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって中国で起きた「各種規制」の影響を主な要因として、これまで市場をけん引してきたスマートフォンや情報端末の販売が急激に鈍化したこと、並びに先進各国において勧められてきたテレワークの減少に伴い、PC及びネットワーク機器などのPC周辺機器に関しても大きく需要が減速、民生機器向け半導体を中心に在庫がだぶつき、各生産工場は生産調整に入りました。このことから当第1四半期連結累計期間における新規設備投資は見送られ、受注残の出荷並びに新規の受注は第2四半期連結会計期間以降となりました。

以上より、当社グループの連結ベース売上高は、82,583千円にとどまり、半導体検査装置事業の利益率が低調であったこと及び労務費・販管費等も増加したことから、営業損失131,890千円となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を139,119千円計上しております。

上記のとおり、継続的な営業損失が発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループでは、こうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）」に記載しております。